



UBA|CBC
Universidad de Buenos Aires
CICLO BÁSICO COMÚN

ANEXO
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CICLO BÁSICO COMÚN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES

ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLÓGICOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 26/2017
CUDAP: EXP-UBA N°: 49.684/2017
(NUEVO LLAMADO)

Por este Pliego de Bases y Condiciones se invita a cotizar en la presente Contratación Directa de conformidad con el procedimiento establecido por Resolución (CS) N° 8240/2013 Artículo 17, Resolución (R) N° 342/16 y Decreto N° 1023/01 Artículo 25 apartado d) inciso 1 y sus modificatorios - Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que se tendrán por conocidos por el oferente al ser presentadas las propuestas, y con las Cláusulas Particulares y las Especificaciones Técnicas que en su caso se detallen.

Resolución (CS) N° 8240/13 Artículos N° 17 y N° 21, Resolución (R) N° 542/16 y Decreto 1023/01 Artículo 25 Apartado d) inciso 1 y sus modificatorias: CONTRATACIÓN DIRECTA

Las contrataciones encuadradas en el Artículo anterior serán hasta el monto estimado del contrato de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TREL MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 693.744).

FECHA DE APERTURA: 11 DE ABRIL DE 2018
HORA: 13:00

C.P. Valeria Alonso
A/c. Jefatura
Departamento Compras y Licitaciones
Ciclo Básico Común
Universidad de Buenos Aires



CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

1. El oferente deberá indicar marcas y modelos de los artículos a proveer y traer folleteria de la mercadería a cotizar, conjuntamente con la oferta, caso contrario no se tomará en cuenta los renglones de la oferta por falta de muestras.
2. Las ofertas deberán ser presentadas mediante sobre cerrado en el Departamento de Compras y Licitaciones del Ciclo Básico Común, sito en Ramos Mejía 841 3º Piso CABA, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Las mismas contendrán en su cubierta la identificación de la contratación a que corresponden, número de expediente, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. Las ofertas se admitirán hasta el día y hora fijados en el llamado.
3. El oferente deberá indicar los datos personales en caso de ser Persona Física o la razón social en caso de ser Persona Jurídica y el N° de C.U.I.T.
4. En todos los casos en que el firmante sea presidente o apoderado de una sociedad o apoderado de una persona física, deberá adjuntar junto con la documentación el poder que se le otorga a dicha persona como representante.
5. Se deberá entregar copia de constancia de Inscripción de AFIP.
6. El Ciclo Básico Común es consumidor final. Se debe incluir el I.V.A. en la cotización y en la facturación. Para la facturación se debe consignar el N° de expediente y de orden de compra.
7. La facturación deberá realizarse dentro de las normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la emisión de comprobantes.
8. Se deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9. No se aceptarán cotizaciones en moneda extranjera, ni adelantos monetarios.
10. Demoras en el Cumplimiento por el proveedor: Una demora injustificada por parte del proveedor, en adelante el "adjudicatario", en el cumplimiento de sus obligaciones, lo harán merecedor de todas o cualquiera de las sanciones siguientes: ejecución de las garantías de cumplimiento, aplicación de multas, imposición de liquidación de los daños y/o rescisión del contrato por incumplimiento.
11. Si en cualquier momento posterior al perfeccionamiento del Contrato "el adjudicatario" se viera en una situación no imputable a él que impidiera el efectivo cumplimiento del mismo, deberá notificar de inmediato al Ciclo Básico Común por escrito la demora, su duración esperada y su causa. El Ciclo Básico Común, tan pronto como sea posible después de recibir la notificación evaluará la situación y podrá a su discreción prorrogar su plazo de cumplimiento siempre y cuando las necesidades del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires admita su satisfacción fuera de término.
12. Multas por mora: Las prórrogas concedidas, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del tres (3) % del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción de tres (3) días.-

C.P. Valeria Alonso
A/c. Jefatura
Departamento Compras y Licitaciones
Ciclo Básico Común
Universidad de Buenos Aires



CONDICIONES PARTICULARES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- 1.- Mantenimiento de Oferta: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.
- 2.- Condiciones de Pago: CONTADO TREINTA (30) DÍAS F.F.
- 3 - Plazo de Entrega: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.
- 4.- Lugar de entrega: CICLO BÁSICO COMÚN, Sede Dr. Ramos Mejía, Franklin 50 CABA, Departamento de Suministros, comunicarse al 5285-4210.
- 5.- Garantía de Oferta: El proponente presentará una garantía por el 5 % del valor total de la oferta sin vencimiento. En todos los casos cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ (\$10.810.-) se exceptúa de la obligación de presentar garantía al Oferente. Toda vez que la garantía supere la suma de \$ 32.430 se deberá presentar un seguro de caución o cheque diferido de propia firma. Respecto a la garantía, en los casos donde un mismo renglón tiene varias opciones, deberá tomarse en cuenta la opción de mayor valor a los efectos de calcular el importe de la oferta para el importe total de garantía.
- 6.- Se deberá presentar Declaración Jurada de inexistencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda obligación previsional y/o tributaria (Ley 17.250 Art. 4°, 5° y 6°) por duplicado.
- 7.- Se deberá presentar Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.
- 8.- El precio individual de cada producto de la oferta deberá tener como máximo 2 (dos) decimales.

C.P. Valeria Alonso
A/c. Jefatura
Departamento Compras y Licitaciones
Ciclo Básico Común
Universidad de Buenos Aires



PLIEGO TÉCNICO

REGLON	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	a) Pcs solo gabinete de acuerdo a las especificaciones técnicas de ANEXO I.	15		
1	b) Pcs solo gabinete de acuerdo a las especificaciones técnicas de ANEXO II.	15		
1	c) Pcs solo gabinete de acuerdo a las especificaciones técnicas de ANEXO III.	15		
16	Kit Iluminador LED 600l li+trípode 2.6 mt	1		
	TOTAL GENERAL.....			

Respecto al renglón nº 1 y, atento que para el mismo hay 3 opciones, a los efectos de la adjudicación se tomarán en forma individual, pudiendo distintos oferentes ser adjudicados por opción

C.P. Valeria Alonso
A/c. Jefatura
Departamento Compras y Licitaciones
Ciclo Básico Común
Universidad de Buenos Aires



ANEXO I

Pcs completas con las características que se detallan o superiores

Procesador:	Características de Intel Core I3 7100 Lga 1151 7gen 3.9ghz o superiores
Mother :	Características de GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 S1150 o superiores
Disco rígido: 1 TB	
Memoria:	8gb 2400mhz Ddr4 (Marca reconocida)
Fuente:	Fuente 650w
SO:	Windows 10 Pro 32/64bits Licencia Digital Original

LEA ATENTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS A CONTINUACION

Características del Procesador (Tipo Intel Core I3 7100 Lga 1151 7gen 3.9ghz o superior)

- Lithography 14 nm
- # of Cores 2
- # of Threads 4
- Processor Base Frequency 3.90 GHz
- Cache 3 MB SmartCache
- Bus Speed 8 GT/s DMI3
- # of QPI Links 0
- TDP 51 W
- Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB
- Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Max # of Memory Channels 2
- ECC Memory Supported #Yes
- Processor Graphics #Intel® HD Graphics 630
- Graphics Base Frequency 350 MHz
- Graphics Max Dynamic Frequency 1.10 GHz
- Graphics Video Max Memory 64 GB
- 4K Support Yes, at 60Hz
- Max Resolution (HDMI 1.4) #4096x2304@24Hz
- Max Resolution (DP) #4096x2304@60Hz
- Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) #4096x2304@60Hz
- DirectX* Support 12
- OpenGL* Support 4.4
- Intel® Quick Sync Video Yes
- Intel® InTru™ 3D Technology Yes
- Intel® Clear Video HD Technology Yes
- Intel® Clear Video Technology Yes
- # of Displays Supported #3
- Device ID 0x5912
- Scalability 1S Only



- PCI Express Revision 3.0
- PCI Express Configurations #Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Max # of PCI Express Lanes 16

Características del Mother (Tipo GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 S1150 , o superior)

Procesador	<ol style="list-style-type: none">1. Soporte para procesadores Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® en empaquetado LGA11502. Caché L3 varía según la CPU
Chipset	<ul style="list-style-type: none">• Chipset Intel® B85 Express
Memoria	<ol style="list-style-type: none">1. 4 x sockets DIMM DDR3 con capacidad para 32 GB de memoria del sistema2. * Debido a una limitación del sistema operativo Windows de 32 bits, cuando hay instalados más de 4 GB de memoria física, el tamaño real de la memoria que muestra el sistema operativo puede ser menor que el tamaño de la memoria física instalada.3. Arquitectura de memoria Dual Channel4. Soporta módulos de memoria DDR3 1600/1333 MHz5. Soporte para módulos de memoria no ECC6. Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP)
Procesador gráfico integrado – Soporte Intel® HD Graphics:	
Gráfica Integrada	<ol style="list-style-type: none">1. 1 x puerto HDMI, con capacidad para una resolución máxima de 4096 x 2160 a 24 Hz / 2560 x 1600 a 60 Hz * Soporta HDMI versión 1.4a.2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.3. 1 x puerto D-Sub, con una resolución máxima de 1920x1200@60 Hz4. Máxima memoria compartida: 1 GB.
Audio	<ol style="list-style-type: none">1. Audio de alta definición2. Codec Realtek® ALC8923. Soporte para salida S / PDIF4. 2/4/5.1/7.1-canales
LAN	<ul style="list-style-type: none">• Chip Realtek® GbE LAN (10/100/1000 Mbit)
Zócalos de Expansión	<ol style="list-style-type: none">1. 1 x ranura PCI Express x16, a velocidad x16 (PCIEX16) (La ranura PCIEX16 cumple el estándar PCI Express 3.0.) * Para un rendimiento óptimo, si sólo se va a instalar una tarjeta gráfica PCI Express, es conveniente instalarla en la ranura PCIEX16.2. 1 x ranura PCI Express x16, a velocidad x4 (PCIEX4) (La ranura PCIEX4 cumple el estándar PCI Express 2.0.)3. 2 x ranura PCI



Tecnología Multi
Gráfica

- Soporta la tecnología AMD CrossFire™.

Chipset:

Interfaz de
almacenamiento

1. 4 x conector SATA a 6Gb/s (SATA2 0/1/2/3) con capacidad para 4 dispositivos SATA a 6Gb/s
2. 2 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2 0/1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices

Chipset:

USB

1. Hasta 8 puertos USB 2.0/1.1 (4 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos)
2. Hasta 4 puertos USB 3.0/2.0 (2 puertos en el panel trasero, 2 puertos disponibles a través del conector USB interno)

Conectores Internos
E/S

1. 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin
2. 1 x conector del ventilador de la CPU
3. 1 x conector del panel frontal
4. 1 x conector de puerto paralelo
5. 1 x conector de alimentación principal ATX 24-pin
6. 1 x conector de audio en el panel frontal
7. 4 x conectores SATA 6 Gb / s
8. 1 x USB 3.0/2.0
9. 1 x conector del ventilador del sistema
10. 2 x conectores USB 2.0/1.1
11. 1 x conector del puerto de serie
12. 1 x Clear CMOS jumper
13. 1 x conector S/PDIF Out
14. 1 x conector Trusted Platform Module (TPM)
15. 2 x conector SATA 3Gb/s

Panel E/S Trasero

1. 4 x puertos USB 2.0/1.1
2. 2 x puerto USB 3.0/2.0
3. 1 x Puerto RJ-45
4. 1 x HDMI
5. 1 x puerto teclado / ratón PS / 2
6. 1 x puerto D-Sub
7. 1 x puerto DVI-D
8. 6 x jacks de audio (central / subwoofer de altavoz / altavoz posterior / salida de altavoz lateral / Entrada de línea / salida de línea / micrófono)

Controlador E/S

- Chip controlador E/S iTE®

Monitorización
Hardware

1. Detección de la temperatura de CPU/Sistema
2. Detección del voltaje del sistema
3. Aviso de sobrecalentamiento de la CPU
4. Control de velocidad para el ventilador de CPU/Sistema
5. Detección de la velocidad del ventilador del CPU/Sistema
6. Advertencia sobre fallos del ventilador del CPU/Sistema



BIOS	<ol style="list-style-type: none">1. 2 x 32 Mbit Flash2. Uso de BIOS AMI EFI con licencia3. Soporta DualBIOS™4. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Otras Características	<ol style="list-style-type: none">1. Soporte para Q-Flash2. Soporta XpressInstall3. Soporte para APP Center4. Soporta EasyTune5. @ BIOS™6. Soporte para On/Off Charge7. Soporta EZ Setup8. USB Blocker
Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none">• Soporte para Windows 8.1/8/7
Formato	<ul style="list-style-type: none">• Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 21.5cm

Características de la memoria (Tipo Kingston HyperxFury Ddr4 2400mhz o superior)

Garantía de por vida (limitada)

CL (IDD):15 Cycles

Row Cycle Time (tRCmin):46.75ns (min)

Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin:):260ns (min)

Row Active Time (tRASmin):29.125ns (min)

UL Rating:94 V – 0

Operating Temperature:0 °C to +85 °C

Power Supply: VDD = 1.2V Typical

VDDQ = 1.2V Typical

VPP – 2.5V Typical

VDDSPD = 2.2V to 3.6V

Nominal and dynamic on-die termination for data, strobe, and mask signals

Low-power auto self refresh (LPASR)

Data bus inversion (DBI) for data bus

On-die VREFDQ generation and calibration

Dual-rank

On-board I2 serial presence-detect (SPD) EEPROM

16 internal banks; 4 groups of 4 banks each

Fixed burst chop (BC) of 4 and burst length of 8 via the mode register set

Selectable BC4 or BL8 on-the-fly (OTF)

Fly-by topology

Terminated control command and address bus

Height 1.230" (31.25mm), w/o heatsink

JEDEC/PnP: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V

JEDEC/PnP: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V

XMP Profile #1: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V

Características del disco (Tipo WD WD10EZEX Caviar Blue o superior)

Capacidad: 1 Tb



Velocidad: 7200 RPM
Cache: 64 Mb
Promedio de latencia: 4,17 ms
Velocidad de transferencia: 6 Gb/s
Interface: Sata 3
Tiempo de lectura: 0,6 ms
Tiempo de escritura: 0,8 ms

Características de la fuente (Tipo Sentey ERP650-PS o superior)

Garantía	3 Años
DC OUTPUTS RANGE	
Entrada CA (A)	10/5A
Frecuencia Entrada CA (Hz)	50-60Hz
Voltaje Entrada CA (Vca)	115/230Vac
Eficiencia a Carga Típica	78%
RANGO DE CARGA	
Potencia Max. de Salida (W)	650 W
Salida Max. de Corriente -12V (A)	0,5 A
Potencia Max. -12V (W)	6 W
Rail de +12V	Single
Salida Max. de Corriente +12V1 (A)	42 A
Potencia Max. +12V1 (W)	504W
Salida Max. de Corriente +3.3V (A)	25 A
Salida Max. de Corriente +5V (A)	25 A
Potencia Max. +3.3V & +5V (W)	150 W
Salida Max. de Corriente +5VSB (A)	2 A
Potencia Max. +5VSB (W)	10 W
CONECTORES	
Motherboard 20+4pines	1
CPU +12V 4+4pines	1
SATA 5pines	4
Molex 4pines	4
Floppy 4pines	1
PCI-E 6pines	1
PCI-E 6+2pines	1



ANEXO II

Pcs solo gabinete con las características que se detallan o superiores

Procesador:	Características de Intel Core I3 7100 Lga 1151 7gen 3.9ghz o superiores
Mother :	Características de Gigabyte Ga H110m H o superiores
Disco rígido:	1 TB
Memoria:	8gb 2400mhz Ddr4 (Marca reconocida)
Fuente:	Tipo Sentey Xcp530-ts 530w o superior
SO:	Windows 10 Pro 32/64bits Licencia Digital Original

LEA ATENTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS A CONTINUACION

Características del Procesador (Tipo Intel Core I3 7100 Lga 1151 7gen 3.9ghz o superior)

- Lithography14 nm
- # of Cores2
- # of Threads4
- Processor Base Frequency3.90 GHz
- Cache3 MB SmartCache
- Bus Speed8 GT/s DMI3
- # of QPI Links0
- TDP51 W
- Max Memory Size (dependent on memory type)64 GB
- Memory TypesDDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Max # of Memory Channels2
- ECC MemorySupported #Yes
- Processor Graphics #Intel® HD Graphics 630
- Graphics Base Frequency350 MHz
- Graphics Max Dynamic Frequency1.10 GHz
- Graphics Video Max Memory64 GB
- 4K SupportYes, at 60Hz
- Max Resolution (HDMI 1.4)#4096x2304@24Hz
- Max Resolution (DP)#4096x2304@60Hz
- Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)#4096x2304@60Hz
- DirectX* Support12
- OpenGL* Support4.4
- Intel® Quick SyncVideoYes
- Intel® InTru™ 3D TechnologyYes
- Intel® Clear Video HD TechnologyYes
- Intel® Clear Video TechnologyYes
- # of DisplaysSupported #3
- Device ID0x5912
- Scalability1S Only
- PCI Express Revision3.0



- PCI Express Configurations #Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Max # of PCI Express Lanes16

Características del Mother (Tipo Gigabyte Ga H110m H, o superior)

Support for 7th/6th Generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package

•Chipset

Intel® H110 Express Chipset

•Memoria

2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory

* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.

Dual channel memory architecture

Support for DDR4 2400/2133 MHz memory modules

Support for ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)

Support for non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules

•Gráficos Integrados

Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support:

1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz

* Support for HDMI 1.4 version.

Maximum shared memory of 1024 MB

•Audio

Realtek® ALC887 codec

High Definition Audio

2/4/5.1/7.1-channel

Support for S/PDIF Out

•LAN

Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

•Puertos de Expansión

1 x PCI Express x16 slot, running at x16

(The PCI Express x16 slot conform to PCI Express 3.0 standard.)

2 x PCI Express x1 slots

(All of the PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)

•Interfaz de Almacenamiento

Chipset:

4 x SATA 6Gb/s connectors

•USB

Chipset:

4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)

6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

•Conectores Internos de E/S

1 x 24-pin ATX main power connector

1 x 4-pin ATX 12V power connector

4 x SATA 6Gb/s connectors



1 x CPU fan header
1 x system fan header
1.1 x front panel header

1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Outheader
1 x USB 3.0/2.0 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
1 x Clear CMOS jumper

•Conectores del Panel Trasero

1 x PS/2 mouse port
1 x PS/2 Keyboardport
1 x D-Sub port
1 x HDMI port
2 x USB 3.0/2.0 ports
2 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In)

•Controlador de E/S

iTE® I/O Controller Chip

•Monitorización H/W

Systemvoltagedetection
CPU/Systemtemperaturedetection
CPU/System fan speeddetection
CPU/Systemoverheatingwarning
CPU/System fan failwarning
CPU/System fan speed control

Características de la memoria (Tipo Kingston HyperxFury Ddr4 2400mhz o superior)

Garantía de por vida (limitada)

CL (IDD):15 Cycles

Row Cycle Time (tRCmin):46.75ns (min)

Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin):260ns (min)

Row Active Time (tRASmin):29.125ns (min)

UL Rating:94 V – 0

Operating Temperature:0 °C to +85 °C

Power Supply: VDD = 1.2V Typical

VDDQ = 1.2V Typical

VPP – 2.5V Typical

VDDSPD = 2.2V to 3.6V

Nominal and dynamic on-die termination for data, strobe, and mask signals

Low-power auto self refresh (LPASR)

Data bus inversion (DBI) for data bus

On-die VREFDQ generation and calibration

Dual-rank

On-board I2 serial presence-detect (SPD) EEPROM

16 internal banks; 4 groups of 4 banks each

Fixed burst chop (BC) of 4 and burst length of 8 via the mode register set

Selectable BC4 or BL8 on-the-fly (OTF)

Fly-by topology



Terminated control command and address bus
Height 1.230" (31.25mm), w/o heatsink
JEDEC/PnP: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V
JEDEC/PnP: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V
XMP Profile #1: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V

Características del disco (Tipo WD WD10EZEX Caviar Blue o superior)

Capacidad: 1 Tb
Velocidad: 7200 RPM
Cache: 64 Mb
Promedio de latencia: 4,17 ms
Velocidad de transferencia: 6 Gb/s
Interface: Sata 3
Tiempo de lectura: 0,6 ms
Tiempo de escritura: 0,8 ms

Características de la fuente (Tipo Sentey Xcp530-ts 530wo superior)

Garantía 2 Años
DC OUTPUTS RANGE
Entrada CA (A) 10/5A
Frecuencia Entrada CA (Hz) 50-60Hz
Voltaje Entrada CA (Vca) 115/230Vac
Eficiencia a Carga Típica 75%
RANGO DE CARGA
Potencia Max. de Salida (W) 530 W
Salida Max. de Corriente -12V (A) 0,5 A
Potencia Max. -12V (W) 6 W
Rail de +12V Single
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) 30 A
Potencia Max. +12V1 (W) 360W
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) 22 A
Salida Max. de Corriente +5V (A) 22 A
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) 120 W
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) 2 A
Potencia Max. +5VSB (W) 10 W
CONECTORES
Motherboard 20+4pines 1
CPU +12V 4+4pines 1
SATA 5pines 4
Molex 4pines 4
Floppy 4pines 1
PCI-E 6+2pines 2
ESPECIFICACIONES FISICAS
Tamaño del Fan Cooler (mm) 140mm Sleeve Bearing
Dimensiones de la fuente (mm) 160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H)
Peso Neto (gr) 1,65 Kg
Pintura de Terminacion Sandy Black



CONECTORES

Factor de Forma ATX
Peso Bruto (gr) 2,65 Kg
Dimensiones de la Caja (mm) 265mm (L) x 195mm (W) x 100mm

PROTECCIONES

Proteccion de Sobre Potencia (OPP) Si
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) Si
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) Si
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) Si

TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS

AMD Crossfire Preparada
NVIDIA SLI Preparada
Sleeve Cables si
PowerCordCertified Si

CERTIFICATIONS & STANDARDS

Type ATX 2.3
RoHs Si
C-tick Si
CB Si
FCC Si
UL S



ANEXO III

Pcs solo gabinete con las características que se detallan o superiores

Procesador:	Características de Intel Dual Core (1151) G4600 3.6 Ghz o superiores
Mother :	Características de Gigabyte Ga H110m H o superiores
Disco rígido:	1 TB
Memoria:	4gb 2400mhz Ddr4 (Marca reconocida)
Fuente:	Tipo Sentey Xcp530-ts 530w o superior
SO:	Windows 10 Pro 32/64bits Licencia Digital Original

LEA ATENTAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS A CONTINUACION

Características del Procesador (Tipo Intel Dual Core (1151) G4600 3.6 Ghz o superior)

- Lithography 14 nm
- # of Cores 2
- # of Threads 4
- Processor Base Frequency 3.60 GHz
- Cache 3 MB
- Bus Speed 8 GT/s DMI3
- # of QPI Links 0
- TDP 51 W
- Max Memory Size (dependent on memory type) 64 GB
- Memory Types DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V
- Max # of MemoryChannels 2
- ECC MemorySupported ‡ Yes
- Processor Graphics ‡Intel® HD Graphics 630
- Graphics Base Frequency 350 MHz
- Graphics Max DynamicFrequency 1.10 GHz
- Graphics Video Max Memory 64 GB
- 4K Support Yes, at 60Hz
- Max Resolution (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
- Max Resolution (DP)‡ 4096x2304@60Hz
- Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 4096x2304@60Hz
- DirectX* Support 12



- OpenGL* Support 4.4
- Intel® Quick Sync Video Yes
- Intel® InTru™ 3D Technology Yes
- Intel® Clear Video HD Technology Yes
- Intel® Clear Video Technology Yes
- # of DisplaysSupported ≠ 3
- Device ID 0x5912
- Scalability 1S Only
- PCI Express Revision 3.0
- PCI Express Configurations ≠Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Max # of PCI Express Lanes 16
- Sockets Supported FCLGA1151
- Max CPU Configuration 1
- Thermal Solution Specification PCG 2015C (65W)
- TJUNCTION 100°C
- PackageSize 37.5mm x 37.5mm
- Intel® Optane™ Memory Supported ≠ No
- Intel® Turbo BoostTechnology ≠ No
- Intel® vPro™ Technology ≠ No
- Intel® Hyper-ThreadingTechnology ≠ Yes
- Intel® Virtualization Technology (VT-x) ≠Yes
- Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ≠Yes
- Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ≠Yes
- Intel® TSX-NI No
- Intel® 64 ≠ Yes
- Instruction Set 64-bit
- Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2
- Idle States Yes
- Enhanced Intel SpeedStep® Technology Yes



- ThermalMonitoring Technologies Yes
- Intel® IdentityProtectionTechnology ‡ Yes
- Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) No
- Intel® AES New Instructions Yes
- Secure Key Yes
- Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Yes
- Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Yes
- Intel® OS Guard Yes
- Intel® TrustedExecutionTechnology ‡ No
- ExecuteDisable Bit ‡ Yes
- Intel® BootGuard Yes

Características del Mother (Tipo Gigabyte Ga H110m H, o superior)

Support for 7th/6th Generation Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors in the LGA1151 package

•Chipset

Intel® H110 Express Chipset

•Memoria

2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory

* Due to a Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than the size of the physical memory installed.

Dual channel memory architecture

Support for DDR4 2400/2133 MHz memory modules

Support for ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)

Support for non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules

•Gráficos Integrados

Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support:

1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz

* Support for HDMI 1.4 version.

Maximum shared memory of 1024 MB

•Audio

Realtek® ALC887 codec

High Definition Audio

2/4/5.1/7.1-channel

Support for S/PDIF Out

•LAN

Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

•Puertos de Expansión



- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
(The PCI Express x16 slot conform to PCI Express 3.0 standard.)
- 2 x PCI Express x1 slots
(All of the PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)

•Interfaz de Almacenamiento

Chipset:

- 4 x SATA 6Gb/s connectors

•USB

Chipset:

- 4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
- 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)

•Conectores Internos de E/S

- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 4-pin ATX 12V power connector
- 4 x SATA 6Gb/s connectors
- 1 x CPU fan header
- 1 x system fan header
- 1.1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x S/PDIF Outheader
- 1 x USB 3.0/2.0 header
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x Trusted Platform Module (TPM) header
- 1 x Clear CMOS jumper

•Conectores del Panel Trasero

- 1 x PS/2 mouse port
- 1 x PS/2 Keyboardport
- 1 x D-Sub port
- 1 x HDMI port
- 2 x USB 3.0/2.0 ports
- 2 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In)

•Controlador de E/S

- ITE® I/O Controller Chip

•Monitorización H/W

- Systemvoltagedetection
- CPU/Systemtemperaturedetection
- CPU/System fan speeddetection
- CPU/Systemoverheatingwarning
- CPU/System fan failwarning
- CPU/System fan speed control

Características de la memoria (Tipo Kingston Hyperx Fury Ddr4 2400mhz o superior)

Garantía de por vida (limitada)

CL (IDD):15 Cycles

Row Cycle Time (tRCmin):46.75ns (min)



Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin): 260ns (min)
Row Active Time (tRASmin): 29.125ns (min)
UL Rating: 94 V – 0
Operating Temperature: 0 °C to +85 °C
Power Supply: VDD = 1.2V Typical
VDDQ = 1.2V Typical
VPP – 2.5V Typical
VDDSPD = 2.2V to 3.6V
Nominal and dynamic on-die termination for data, strobe, and mask signals
Low-power auto self refresh (LPASR)
Data bus inversion (DBI) for data bus
On-die VREFDQ generation and calibration
Dual-rank
On-board I2 serial presence-detect (SPD) EEPROM
16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
Fixed burst chop (BC) of 4 and burst length of 8 via the mode register set
Selectable BC4 or BL8 on-the-fly (OTF)
Fly-by topology
Terminated control command and address bus
Height 1.230" (31.25mm), w/o heatsink
JEDEC/PnP: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V
JEDEC/PnP: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V
XMP Profile #1: DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V

Características del disco (Tipo WD WD10EZEX Caviar Blue o superior)

Capacidad: 1 Tb
Velocidad: 7200 RPM
Cache: 64 Mb
Promedio de latencia: 4,17 ms
Velocidad de transferencia: 6 Gb/s
Interface: Sata 3
Tiempo de lectura: 0,6 ms
Tiempo de escritura: 0,8 ms

Características de la fuente (Tipo Sentey Xcp530-ts 530wo superior)

Garantía 2 Años
DC OUTPUTS RANGE
Entrada CA (A) 10/5A
Frecuencia Entrada CA (Hz) 50-60Hz
Voltaje Entrada CA (Vca) 115/230Vac
Eficiencia a Carga Típica 75%
RANGO DE CARGA
Potencia Max. de Salida (W) 530 W
Salida Max. de Corriente -12V (A) 0,5 A
Potencia Max. -12V (W) 6 W
Rail de +12V Single
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) 30 A
Potencia Max. +12V1 (W) 360W
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) 22 A
Salida Max. de Corriente +5V (A) 22 A



RANGO DE CARGA

Potencia Max. +3.3V & +5V (W) 120 W

Salida Max. de Corriente +5VSB (A) 2 A

Potencia Max. +5VSB (W) 10 W

CONECTORES

Motherboard 20+4pines 1

CPU +12V 4+4pines 1

SATA 5pines 4

Molex 4pines 4

Floppy 4pines 1

PCI-E 6+2pines 2

ESPECIFICACIONES FISICAS

Tamaño del Fan Cooler (mm) 140mm Sleeve Bearing

Dimensiones de la fuente (mm) 160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H)

Peso Neto (gr) 1,65 Kg

Pintura de Terminacion Sandy Black

Factor de Forma ATX

Peso Bruto (gr) 2,65 Kg

Dimensiones de la Caja (mm) 265mm (L) x 195mm (W) x 100mm

PROTECCIONES

Proteccion de Sobre Potencia (OPP) Si

Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) Si

Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) Si

Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) Si

TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS

AMD Crossfire Preparada

NVIDIA SLI Preparada

Sleeve Cables si

PowerCordCertified Si

CERTIFICATIONS & STANDARDS

Type ATX 2.3

RoHs Si

C-tick Si

CB Si

FCC Si

UL S



1.1 DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES y TODA OBLIGACIÓN PREVISIONAL y/o TRIBUTARIA.

CUIT:
Razón Social:
Denominación o
Nombre Completo:

Procedimiento de selección

Tipo:
Clase:
Modalidad:
Número:
Ejercicio:
Lugar, día y hora del
Acto de apertura:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, **DECLARA BAJO JURAMENTO**, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no presenta a la fecha deuda exigible alguna en concepto de aportes, contribuciones y toda obligación previsional y/o tributaria, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 4, 5 y 6 de la Ley 17.250 "Prestaciones Previsionales".

Prestaciones Previsionales
Ley 17.250

Art. 4.- Será requisito indispensable la presentación de una declaración jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22 Ver texto de la ley 14236 y 12 Ver texto de la ley 14499, para la realización de los siguientes actos: inscripción en los registros de importadores y exportadores, despachantes de aduana, entidades o personas autorizadas para operar en cambios, constructores de obras públicas y proveedores del Estado Nacional, de las provincias o de las Municipalidades; autorización para operar como corredor o comisionista de bolsa o mercado, y para cotizar acciones en bolsa o mercados; tramitaciones municipales para la habilitación de instalaciones comerciales o industriales, y conexión de fuerza motriz, suministro de energía eléctrica, gas o teléfono, con destino comercial o industrial.

Art. 5.- Las personas físicas o de existencia ideal que no desarrollen actividades comprendidas en alguna de las cajas nacionales de previsión, o estuvieren exentas de la obligación de afiliarse, deberán en los casos de los artículos 2 Ver texto, inciso B) y C) y 4 Ver texto de la presente ley, presentar una declaración jurada haciendo constar esa circunstancia.

Art. 6.- Las declaraciones juradas a que se refieren los artículos precedentes contendrán los datos que determine la reglamentación, y serán presentadas por triplicado. Uno de los ejemplares será devuelto al interesado, con la constancia de la presentación; otro será remitido al Instituto Nacional de Previsión Social por la entidad o repartición receptora, y el tercero quedará en poder de estas últimas.

La no presentación de dichas declaraciones juradas dará lugar a la paralización de los trámites correspondientes.

Firma:
Aclaración:
Carácter:
Lugar y Fecha:



1.2 DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CUIT:
Razón Social:
Denominación o
Nombre Completo:

Procedimiento de selección

Tipo:
Clase:
Modalidad:
Número:
Ejercicio:
Lugar, día y hora del
Acto de apertura:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, **DECLARA BAJO JURAMENTO**, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y modificatorias.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará al Órgano Rector, que en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art.28.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

- a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
- g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156

Firma:
Aclaración:
Carácter:
Lugar y Fecha: